

2005年3月期 決算説明資料

2005年5月16日
信越化学工業株式会社

見通しに関する注記事項

当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

目

次

(連結決算)

・業績の概要 (連結・単独)	1 頁
・決算の主要項目 (連結・単独)	2 頁
・セグメント別売上高・営業利益	3 頁
・有機・無機化学品事業の推移・現況	4 頁
・電子材料事業の推移・現況	5 頁
・機能材料その他事業の推移・現況	6 頁
・シンテック社の業績概要	7 頁
・信越半導体グループの業績概要	8 頁
・比較損益計算書	9 頁
・比較貸借対照表	10 頁
・比較キャッシュフロー計算書	11 頁
・2006年3月期業績予想 (連結・単独)	12 頁

(単独決算)

・比較損益計算書	13 頁
・比較貸借対照表	14 頁

業績の概要（連結・単独）

	連 結			単 独			連単倍率	
	2004年 3月期	2005年 3月期	増 減	2004年 3月期	2005年 3月期	増 減	2004年 3月期	2005年 3月期
売上高	8,328	9,675	(16.2%) 1,347	4,826	5,203	(7.8%) 377	1.73	1.86
営業利益	1,256	1,517	(20.8%) 261	561	631	(12.5%) 70	2.24	2.41
経常利益	1,256	1,515	(20.6%) 259	581	620	(6.8%) 39	2.16	2.44
当期純利益	748	932	(24.5%) 184	347	390	(12.4%) 43	2.15	2.39
総資産	13,862	14,762	900	7,588	7,779	191	1.83	1.90
株主資本	9,007	9,963	956	5,443	5,880	437	1.65	1.69
株主資本比率	65.0%	67.5%	2.5ポイント	71.7%	75.6%	3.9ポイント		
1株当たり								
当期純利益	177.25円	219.10円	41.85円	82.25円	91.73円	9.48円		
株主資本	2,140円	2,329円	189円	1,293円	1,375円	82円		
年間配当金	/	/	/	16.0円	20.0円	4円増配		
R O E	8.6%	9.8%	1.2ポイント	6.6%	6.9%	0.3ポイント		
R O A	9.3%	10.6%	1.3ポイント	8.1%	8.1%	0.0ポイント		

（注）ROAは総資本経常利益率。

決算の主要項目（連結・単独）

（億円）

	連 結		単 独	
	2004年 3月期	2005年 3月期	2004年 3月期	2005年 3月期
設 備 投 資 額	1,136	1,103	167	172
減 価 償 却 額	736	909	201	210
研 究 費	264	279	156	175
有 利 子 負 債 残 高	1,632	1,204	638	332
期 末 従 業 員 数	17,384人	18,151人	2,571人	2,517人
為替レート：1-12月平均	116.0円	108.2円	-	-
（US\$）4-3月平均	113.1円	107.5円	113.1円	107.5円

（注）1．2005年3月期（連結）設備投資額、減価償却費の内訳

	設備投資額	減価償却費
	億円	億円
有機・無機化学品	344	261
電子材料	668	550
機能材料その他	94	100

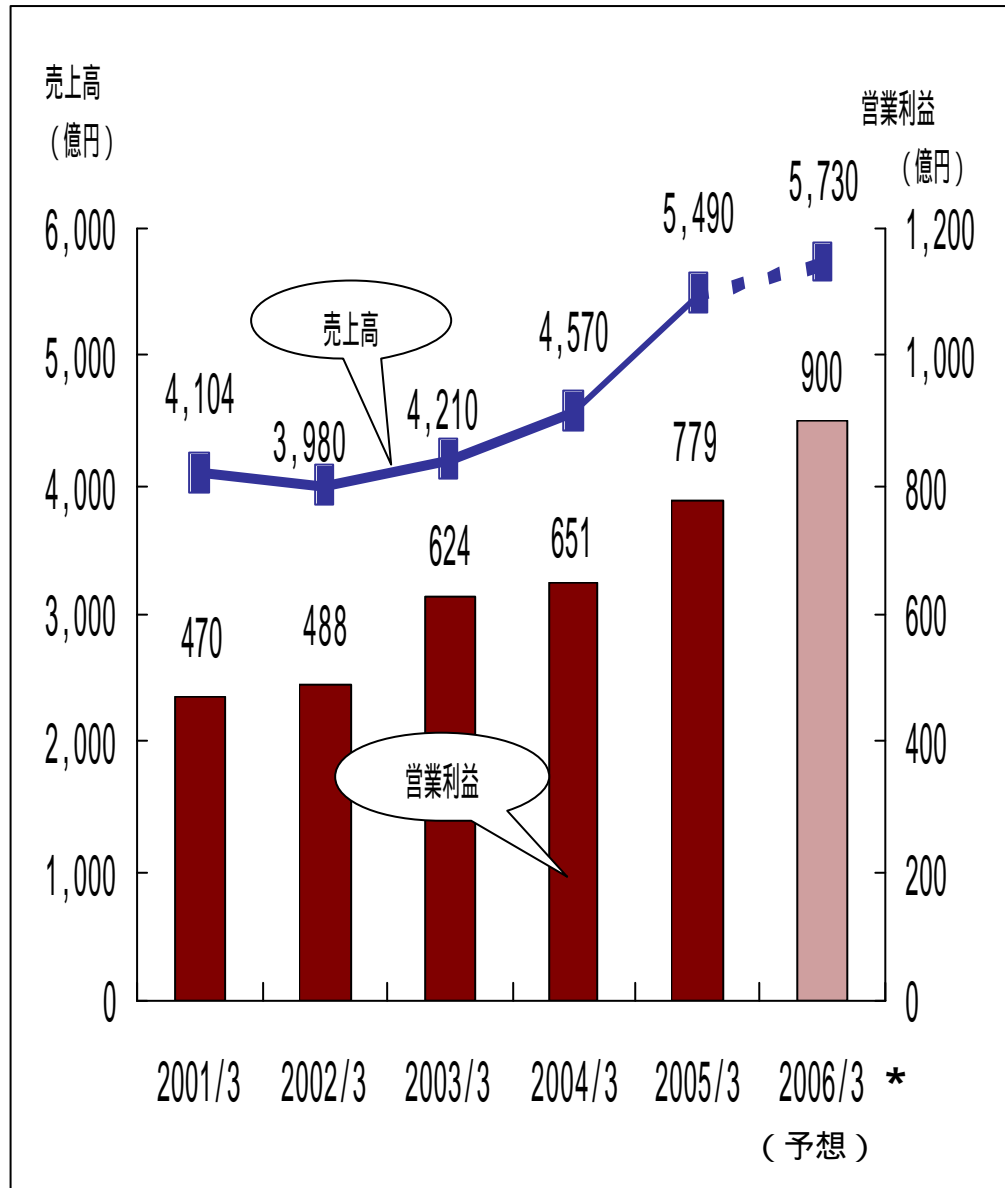
2．1-12月平均の為替レートは、海外子会社の損益を連結する際に使用。

セグメント別売上高・営業利益（連結）

（億円）

	売上高			営業利益		
	2004年 3月期	2005年 3月期	増減	2004年 3月期	2005年 3月期	増減
有機・無機化学品	4,570	5,490	(20.1%) 920	651	779	(19.6%) 128
塩ビ系	2,549	2,965	416	237	308	71
シリコン系	1,358	1,559	201	266	294	28
その他	663	966	303	148	177	29
電子材料	2,622	3,069	(17.0%) 447	422	537	(27.3%) 115
半導体シリコン	2,141	2,566	425	348	452	104
その他	481	503	22	74	85	11
機能材料その他	1,136	1,116	(1.7%) 20	182	201	(10.8%) 19
合成石英	257	265	8	91	108	17
希土類磁石、 その他機能材料	265	282	17	47	49	2
その他	614	569	45	43	44	1
消 去	-	-	-	1	0	1
合 計	8,328	9,675	(16.2%) 1,347	1,256	1,517	(20.8%) 261

有機・無機化学品事業の推移・現況（連結）



塩ビ

世界的な原料価格の高騰が続いたものの、米国のシンテック社が、幅広い顧客を国内外に持つ強みを活かしくめ細かい営業活動を行い、また、建設・住宅向けを中心とした旺盛な需要に支えられ、売上と営業利益を増加させた。

オランダのシンエツPVC社も、欧州における需要が堅調で原料高による価格改定も行き、業績を伸長させた。

国内塩ビ事業は、販売価格の是正や中国向け輸出が寄与し、収益は大きく改善した。

この結果、塩ビ事業の収益は順調に増加した。

現在、シンテック社は、電解から塩化ビニル樹脂までの大型一貫製造工場の建設計画に取り組んでおり、シンエツPVC社も、市場の伸びに応じた能力増強を順次行っている。

シリコン

国内販売が自動車・情報機器・建材向けを中心に堅調だったことに加え、中国や米国向けの販売も好調で、売上、営業利益とも増加した。

今後は、新製品の開発を促進し、国内、タイ、米国の各工場の安定操業に注力し事業の拡大に努める。

セルロース

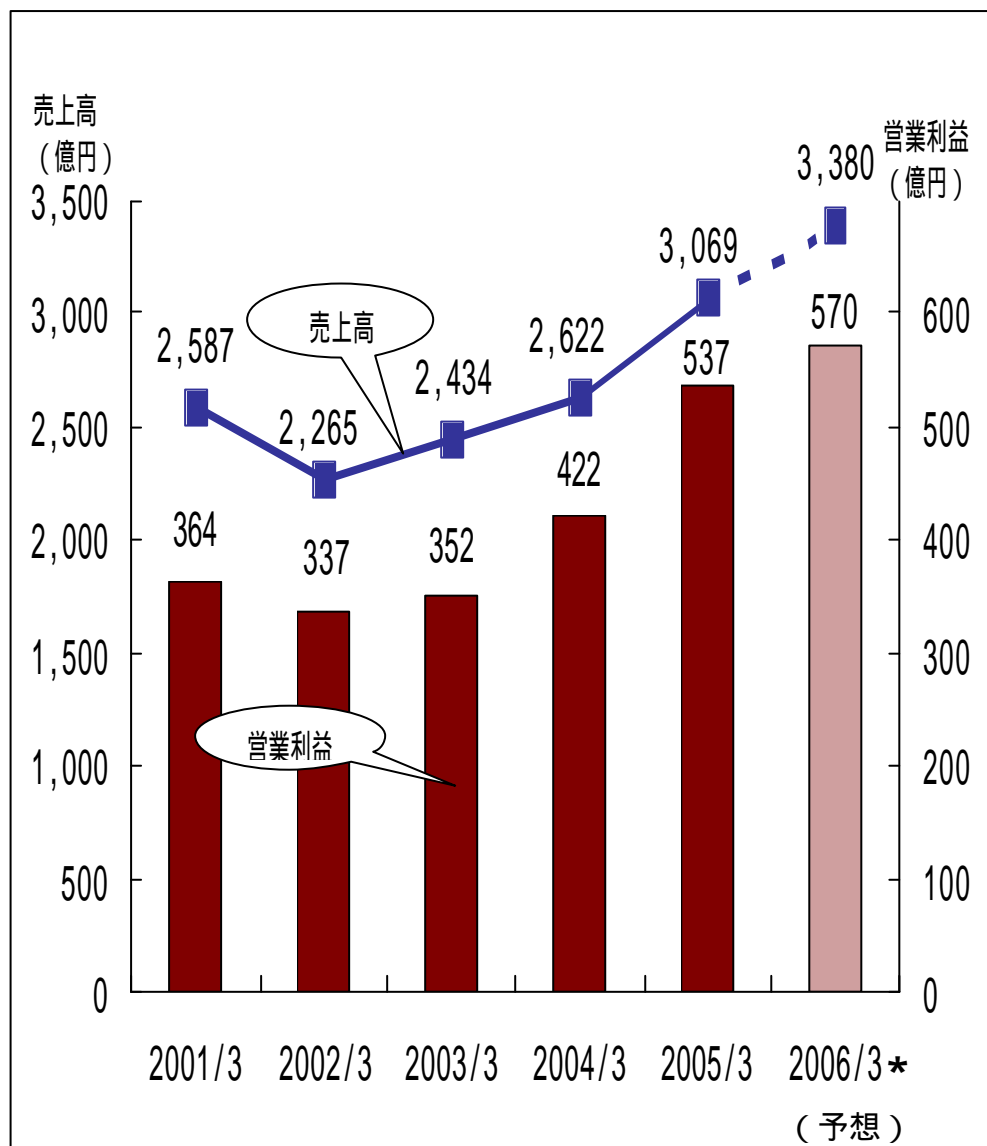
国内事業が医薬品向けや自動車関連向けを中心に堅調に推移したほか、平成15年12月に買収したドイツのSEタイロース社も建材向けの販売が好調だった。

現在、日本とドイツそれぞれの工場で生産能力の増強に取り組んでいる。

（注）海外子会社は12月決算のため1～12月期を算入。

* 予想の数字については、本資料表紙の「見通しに関する注記事項」をご覧ください。

電子材料事業の推移・現況（連結）



半導体シリコン

パソコンやデジタル家電、携帯電話向けデバイスの需要拡大により好調に推移してきた200mmウェハーが、期後半から若干の調整局面を迎えたが、300mmウェハーが大手デバイスメーカーの需要拡大を受け、期を通じて順調に推移した。

SOIウェハー、熱処理ウェハーなどの特殊ウェハーも寄与した結果、売上、営業利益とも大幅に増加した。

現在、300mmウェハーの需要増大に対応して信越半導体(株)白河工場の生産能力増強を行うとともに、米国での結晶生産を開始し、供給能力の分散と安定供給の向上を図っていく。

電子産業用希土類磁石

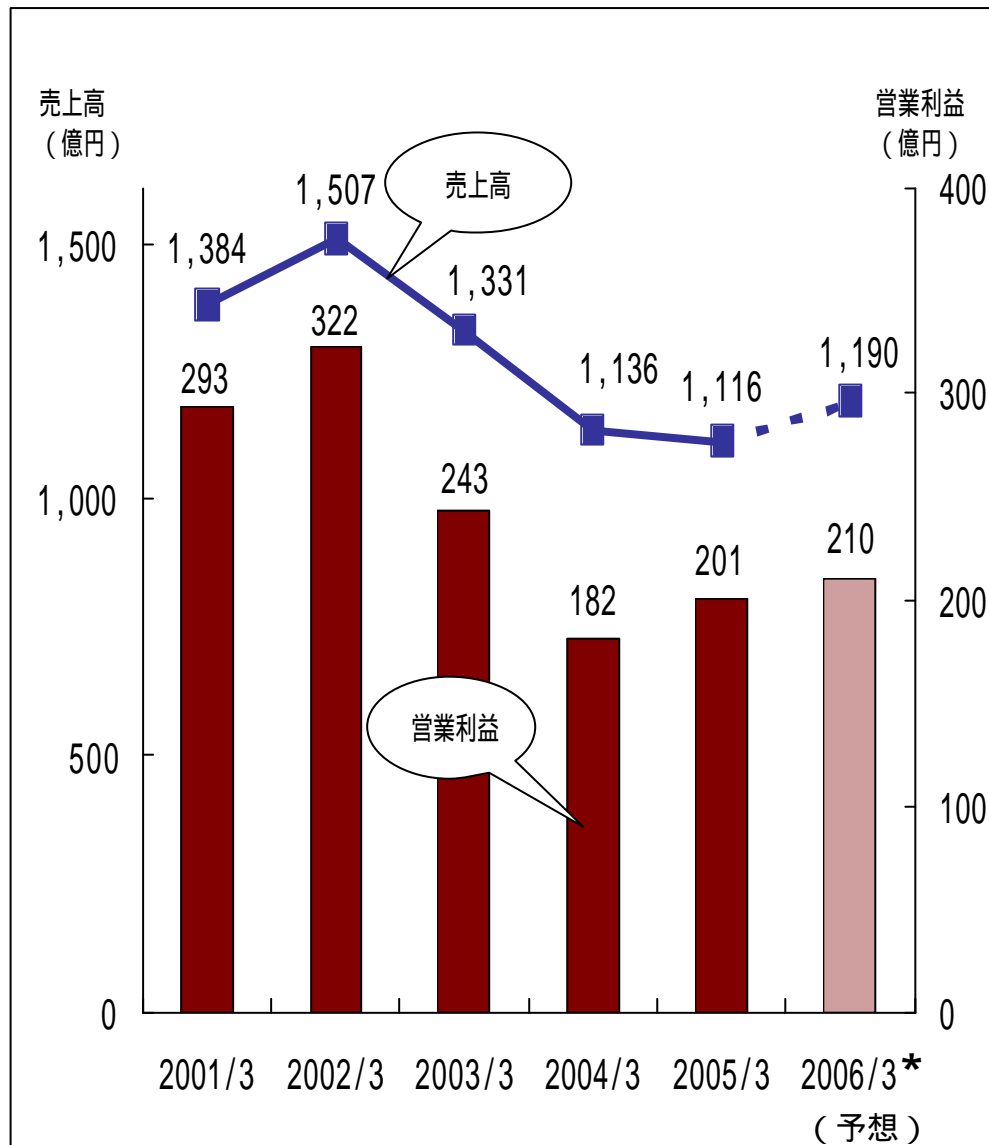
パソコン用、サーバー用、映像記録用に加え、携帯音楽プレイヤー用などの各種ハードディスク・ドライブ向けが順調だった。

電子産業用有機材料・フォトレジスト

電子産業用有機材料及びフォトレジスト製品は、半導体デバイス向けが堅調に推移した。

* 予想の数字については、本資料表紙の「見通しに関する注記事項」をご覧ください。

機能材料その他事業の推移・現況（連結）



合成石英

光ファイバー用プリフォームは世界的に需要の低迷が続いたものの、液晶パネルの製造時に使用される大型マスク基板が好調で、売上は増加した。

希土類磁石

エアコン向けや自動車向け、FA機器向けなどを中心に堅調に推移した。

その他事業

各種プラント等の設計・建設は堅調だったものの、一般商品の販売が減少した。

* 予想の数字については、本資料表紙の「見通しに関する注記事項」をご覧ください。

シンテック社の業績概要

Shintech Incorporated

	2003年12月期		2004年12月期	
	百万US\$	億 円	百万US\$	億 円
売上高	1,440	1,671	1,821	1,971
経常利益	205	238	251	271
当期純利益	134	155	165	179
純資産	1,531	1,640	1,696	1,767
総資産	1,818	1,948	1,979	2,062

- 米国内の旺盛な住宅投資等に牽引され、米国の塩ビ需要は前年に対して6.6%増加した。また、原油・天然ガス等の基礎原料価格が高騰したこともあり、米国の塩ビの販売価格は約4割上昇した。
- 2004年10月に操業開始30年を迎えたシンテック社は、米国の堅調な塩ビ需要に応え、また、世界中に幅広い顧客を有している強みを活かしながら市況を正確に捉えた販売を行い、テキサス州、ルイジアナ州の2工場がフル操業を継続し、売上、利益とも増加した。

信越半導体グループの業績概要

信越半導体グループ〔連結業績〕

(信越半導体・SEHアメリカ・SEHマレーシア・SEHヨーロッパ・SEH台湾)

	2004年 3月期 億円	2005年 3月期 億円
売上高	2,067	2,504
経常利益	236	361
特別利益	21	-
特別損失	13	-
当期純利益	147	231
純資産	1,267	1,492
総資産	3,309	3,512

- 300mmウェハ―は既存ユーザーの増産及び新規ユーザー向けに販売量が增大した。
- 200mm以下のウェハ―は、パソコン、デジタル民生機器向け等の半導体需要増により上半期は好調に推移した。下半期はDRAMや車載向け半導体は好調を維持したが、他のデバイス向けは生産・在庫調整の影響を受けた。
- SOIウェハ―、熱処理ウェハ―等の特殊ウェハ―も堅調に推移した。
- この結果、売上、経常利益とも前期を大幅に上回る結果となった。

(注) 子会社は12月決算数値を連結

比較損益計算書（連結）

（億円）

	2004年 3月期	2005年 3月期	増 減	増減率
売 上 高	8,328	9,675	1,347	16.2%
売上原価	6,191	7,151	960	
販売費・一般管理費	881	1,006	125	
営 業 利 益	1,256	1,517	261	20.8%
営業外損益	0	2	2	
経 常 利 益	1,256	1,515	259	20.6%
特別損益	0	-	0	
税金等調整前当期純利益	1,256	1,515	259	20.6%
法人税・住民税・事業税	484	552	68	
少数株主利益(減算)	24	31	7	
当 期 純 利 益	748	932	184	24.5%

比較貸借対照表 (連結)

(億円)

	2004年 3月末	2005年 3月末	前期末比		2004年 3月末	2005年 3月末	前期末比
流動資産	<u>7,305</u>	<u>7,808</u>	<u>503</u>	流動負債	<u>3,217</u>	<u>3,312</u>	<u>95</u>
現金・預金	2,103	2,467	364	支払手形・買掛金	1,070	1,147	77
受取手形・売掛金	2,220	2,364	144	短期借入金	583	376	207
有価証券	1,312	1,058	254	社債・転換社債	80	59	21
たな卸資産	1,177	1,352	175	未払金・未払費用	1,096	1,292	196
繰延税金資産	227	278	51	未払法人税等	295	360	65
その他	266	289	23	その他	93	78	15
				固定負債	<u>1,372</u>	<u>1,197</u>	<u>175</u>
固定資産	<u>6,557</u>	<u>6,954</u>	<u>397</u>	社債・転換社債	411	270	141
有形固定資産	<u>4,349</u>	<u>4,482</u>	<u>133</u>	長期借入金	558	499	59
建物・構築物	1,534	1,549	15	繰延税金負債	331	334	3
機械装置・運搬具	2,009	2,132	123	退職給付引当金	60	77	17
その他	807	800	7	その他	12	17	5
無形固定資産	<u>244</u>	<u>286</u>	<u>42</u>	負債合計	4,590	4,509	81
投資その他の資産	<u>1,964</u>	<u>2,186</u>	<u>222</u>	少数株主持分	265	291	26
投資有価証券	1,715	1,806	91	資本金	1,105	1,175	70
繰延税金資産	130	148	18	資本剰余金	1,193	1,263	70
その他	119	232	113	利益剰余金	6,950	7,802	852
				<small>その他有価証券評価差額金</small>	119	137	18
				<small>為替換算調整勘定</small>	267	303	36
				自己株式	92	111	19
				資本合計	9,007	9,963	956
資産合計	13,862	14,762	900	負債・少数株主・資本合計	13,862	14,762	900

比較キャッシュフロー計算書 (連結)

(億円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	増 減
営業活動によるキャッシュフロー			
当期純利益	748	932	184
減価償却費	736	909	173
その他	76	67	143
計	1,560	1,774	214
投資活動によるキャッシュフロー			
設備投資支出	712	968	256
新規連結子会社等取得による支出	302	57	245
金融債ほか有価証券増減額	287	39	326
長期性預金の預入による支出	-	100	100
その他	11	2	13
計	1,290	1,088	202
財務活動によるキャッシュフロー			
社債・借入金増減額	45	317	272
リース契約解約による支出	156	-	156
配当金支払額	63	76	13
その他	3	26	23
計	267	419	152
換算差額ほか	97	20	77
現金・現金同等物増減額	94	247	341
現金・現金同等物残高	2,930	3,177	247
有利子負債残高	1,632	1,204	428

2006年3月期 業績予想（連結・単独）

	連 結				単 独			
			上 期				上 期	
	億 円	前期比(%)	億 円	前期比(%)	億 円	前期比(%)	億 円	前期比(%)
売 上 高	10,300	6.5	5,100	8.9	5,400	3.8	2,650	3.5
営 業 利 益	1,680	10.7	845	10.1	680	7.8	340	7.7
経 常 利 益	1,680	10.9	840	10.8	680	9.6	340	9.5
当 期 純 利 益	1,030	10.6	515	10.8	430	10.2	215	10.0
1株当たり当期純利益	240.05円	20.95円	120.46円	10.09円	100.17円	8.44円	50.29円	3.88円
1株当たり年間配当金	30.00円	10円増配	15.00円	5円増配				

*業績予想については、本資料表紙の「見通しに関する注記事項」をご覧ください。

比較損益計算書（单独）

（億円）

	2004年 3月期	2005年 3月期	増 減	増減率
売 上 高	4,826	5,203	377	7.8%
売上原価	3,954	4,243	289	
販売費・一般管理費	311	329	18	
営 業 利 益	561	631	70	12.5%
営業外損益	20	11	31	
経常利益(税引前当期純利益)	581	620	39	6.8%
法人税・住民税・事業税	233	230	3	
当期純利益	347	390	43	12.4%

比較貸借対照表（単独）

（億円）

	2004年 3月末	2005年 3月末	前期末比		2004年 3月末	2005年 3月末	前期末比
流動資産	<u>4,298</u>	<u>4,386</u>	<u>88</u>	流動負債	<u>1,730</u>	<u>1,665</u>	<u>65</u>
現金・預金	1,353	1,443	90	支払手形・買掛金	902	930	28
受取手形・売掛金	1,524	1,577	53	短期借入金	310	144	166
有価証券	473	325	148	一年以内償還転換社債	-	38	38
たな卸資産	378	399	21	未払金・未払費用	318	383	65
その他	571	642	71	未払法人税等	177	161	16
				その他	23	9	14
固定資産	<u>3,290</u>	<u>3,393</u>	<u>103</u>	固定負債	<u>416</u>	<u>234</u>	<u>182</u>
有形固定資産	<u>1,114</u>	<u>1,056</u>	<u>58</u>	転換社債	178	-	178
建物・構築物	364	355	9	長期借入金	150	150	0
機械装置・車両運搬具	479	449	30	その他	88	84	4
その他	271	252	19	負債合計	<u>2,146</u>	<u>1,899</u>	<u>247</u>
無形固定資産	<u>12</u>	<u>10</u>	<u>2</u>				
投資その他の資産	<u>2,164</u>	<u>2,328</u>	<u>164</u>	資本金	1,105	1,175	70
投資有価証券	1,159	1,113	46	資本剰余金	1,119	1,189	70
関係会社株式	954	1,025	71	利益剰余金	3,206	3,518	312
その他	51	190	139	その他有価証券評価差額金	105	109	4
				自己株式	92	111	19
				資本合計	<u>5,443</u>	<u>5,880</u>	<u>437</u>
資産合計	<u>7,588</u>	<u>7,779</u>	<u>191</u>	負債・資本合計	<u>7,588</u>	<u>7,779</u>	<u>191</u>

過去 1年の信越グループの主な展開

- 2004年4月 アジア・シリコーンズ・モノマー社（タイ）が、シリコーン製品の間接原料の商業生産を開始。
- 2004年4月 信越ポリマー（株）が、生産子会社のシンエツ・ポリマー・ハンガリー社で、主力製品の携帯電話や電装用キーパッドの生産を開始。
- 2004年7月 信越ポリマー（株）が、シンセン（中国）でのOEMによる塩ビコンパウンドの生産を開始。
- 2004年8月 塩化ビニル樹脂製品の日本国内での再値上げを発表。
- 2004年8月 セルロース誘導体製品の日本国内での値上げを発表。
- 2004年9月 シリコーン樹脂製品の日本国内での値上げを発表。
- 2004年10月 半導体封止用エポキシモールドディングコンパウンドの値上げを発表。
- 2004年10月 シンテック社が操業開始30周年を迎える。
- 2004年12月 シンテック社の塩ビ一貫製造工場の建設計画を発表。
- 2004年12月 信越半導体（株）の国内外での300mmウェハー生産能力の増強計画を発表。
- 2005年1月 シンエツPVC社（オランダ）の工場増設計画を発表。
- 2005年1月 ムーディーズが信越化学の格付けをA2からA1へ引き上げ。
- 2005年3月 メチルセルロース生産能力の日独での増強計画を発表。
- 2005年3月 日本酢ビ・ポバール株式会社の完全子会社化を発表。
- 2005年3月 ネオジム系希土類磁石の高性能化技術を開発。